

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



香港聯交所股票代號：1347

新聞稿

華虹半導體二零二二年第二季度業績公佈

所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。

本合併財務報告系依香港財務報告準則編製。

中國香港 — 2022年8月11日 — 全球領先的特色工藝純晶圓代工廠華虹半導體有限公司（香港聯交所股票代號：1347）（「本公司」）於今日公佈截至二零二二年六月三十日止三個月的綜合經營業績。

二零二二年第二季度主要財務指標（未經審核）

- 銷售收入再創歷史新高，達 6.208 億美元，同比上升 79.4%，環比上升 4.4%。
- 毛利率 33.6%，同比上升 8.8 個百分點，環比上升 6.7 個百分點。
- 期內溢利 5,320 萬美元，同比上升 43.2%，環比下降 47.8%，主要由於本季度產生較大外幣匯兌損失。
- 母公司擁有人應佔溢利 8,390 萬美元，同比上升 90.4%，環比下降 18.5%。
- 基本每股盈利 0.064 美元，同比上升 88.2%，環比下降 19.0%。
- 淨資產收益率（年化）11.5%，同比上升 4.7 個百分點，環比下降 2.6 個百分點。

二零二二年第三季度指引

- 我們預計銷售收入約 6.25 億美元左右。
- 我們預計毛利率約在 33%至 34%之間。

總裁致辭

公司總裁兼執行董事唐均君先生對二零二二年第二季度業績評論到：

“我們對華虹半導體在二零二二年第二季度的業績感到滿意。受益於市場對公司所有特色工藝平臺的持續性需求，華虹半導體的 12 英寸晶圓廠和三座 8 英寸晶圓廠都保持滿載運營。本季度，公司營收達到創紀錄的 6.208 億美元，同比增加 79.4%，環比增加 4.4%；毛利率達到了 33.6%，較去年同期提高 8.8 個百分點，較上一季度高出 6.7 個百分點。”

唐總繼續講道：“為進一步鞏固公司在特色工藝領域的龍頭地位，把握汽車電子、新能源等新興市場的機遇，我們將堅定特色工藝高品質發展，繼續專注於深耕非易失性存儲器、功率器件、模擬和電源管理、邏輯和射頻及其他特色工藝平臺，為全球客戶提供卓越的產品解決方案。儘管當前全球經濟環境不確定性因素持續增多，但機會總是屬於有準備的人。”

電話會議公告

- 日期 2022 年 8 月 11 日 (星期四)
- 時間: 16:00 香港/上海时间
04:00 美国东部时间
- 發言人: 唐均君, 總裁兼執行董事
王鼎, 執行副總裁兼首席財務官
- 廣播: 該電話會議將於下述網站進行語音及幻燈片直播:
http://www.huahonggrace.com/c/investor_webcast.php 或
<https://edge.media-server.com/mmc/p/6x6o37ix>
(注: 需要註冊才能訪問網絡直播)
- 電話直撥: 請在會議前使用以下鏈接先進行註冊。註冊後, 您將收到確認郵件獲得撥入號碼及個人 PIN。
<https://register.vevent.com/register/BI43f528788fd54c0cb9f39da1491ba69a>
重要提示: 在會議開始前, 您需要使用確認郵件中提供的個人 PIN 才能進入會議。請在註冊後, 注意查收並保存確認郵件。出於安全原因, 請不要與任何人共享您的 PIN。
- 網上重播: 直播約 24 小時後, 您可於 12 個月內在以下網頁重複收聽會議。
http://www.huahonggrace.com/s/investor_webcast.php

關於華虹半導體

華虹半導體有限公司 (「華虹半導體」, 股份代號: 1347.HK) (「本公司」) 是全球領先的特色工藝純晶圓代工企業, 專注於非易失性存儲器、功率器件、模擬及電源管理和邏輯及射頻等「8 英寸 + 12 英寸」特色工藝技術的持續創新, 「特色 IC + Power Discrete」強大的工藝技術平台有力支持物聯網等新興領域應用, 其卓越的質量管理體系亦滿足汽車電子芯片生產的嚴苛要求。本公司是華虹集團的一員, 而華虹集團是以集成電路製造為主業, 擁有「8 英寸 + 12 英寸」生產線先進工藝技術的企業集團。

本公司在上海金橋和張江建有三座 8 英寸晶圓廠 (華虹一廠、二廠及三廠), 月產能約 18 萬片。同時在無錫高新技術產業開發區內有一座月產能 6.5 萬片的 12 英寸晶圓廠 (華虹七廠), 不僅是中國大陸領先的 12 英寸特色工藝生產線, 亦為全球第一條 12 英寸功率器件代工生產線。

如欲取得更多公司相關資料, 請瀏覽: www.huahonggrace.com。

經營業績概要
(以千美元計，每股盈利和營運數據除外)

	二零二二年 第二季度 (未經審核)	二零二一年 第二季度 (未經審核)	二零二二年 第一季度 (未經審核)	同比	環比
銷售收入	620,823	346,110	594,648	79.4 %	4.4 %
銷售成本	(411,953)	(260,440)	(434,625)	58.2 %	(5.2)%
毛利	208,870	85,670	160,023	143.8 %	30.5 %
毛利率	33.6 %	24.8 %	26.9 %	8.8	6.7
經營開支	(70,676)	(45,905)	(75,264)	54.0 %	(6.1)%
其他(損失)/收入淨額	(56,675)	11,896	10,479	(576.4)%	(640.8)%
稅前溢利	81,519	51,661	95,238	57.8 %	(14.4)%
所得稅(開支)/抵免	(28,272)	(14,483)	6,865	95.2 %	(511.8)%
期內溢利	53,247	37,178	102,103	43.2 %	(47.8)%
淨利潤率	8.6 %	10.7 %	17.2 %	(2.1)	(8.6)
以下各方應佔利潤：					
母公司擁有人	83,933	44,082	102,944	90.4 %	(18.5)%
非控股權益	(30,686)	(6,904)	(841)	344.5 %	3,548.8 %
持有人應佔每股盈利					
基本	0.064	0.034	0.079	88.2 %	(19.0)%
攤薄	0.064	0.033	0.078	93.9 %	(17.9)%
付運晶圓(折合 8 吋仟片)	1,036	730	1,057	41.9 %	(2.0)%
產能利用率 ¹	109.7 %	109.5 %	106.0 %	0.2	3.7
淨資產收益率 ²	11.5 %	6.8 %	14.1 %	4.7	(2.6)

二零二二年第二季度

- 銷售收入再創歷史新高，達 6.208 億美元，同比上升 79.4%，環比上升 4.4%。
- 銷售成本 4.120 億美元，同比上升 58.2%，主要由於晶圓銷售量上升及折舊成本上升，環比下降 5.2%，主要由於獎金減少及晶圓銷售量下降。
- 毛利率 33.6%，同比上升 8.8 個百分點，環比上升 6.7 個百分點，主要得益於平均銷售價格上漲。
- 經營開支 7,070 萬美元，同比上升 54.0%，主要由於人工開支上升及研發活動的政府補助減少，環比下降 6.1%，主要由於獎金減少。
- 其他損失淨額 5,670 萬美元，主要由於本季度外幣匯兌損失較大，而上年同期及上季度均為外幣匯兌收益。
- 所得稅開支 2,830 萬美元，同比上升 95.2%，主要由於應課稅利潤增加。
- 期內溢利 5,320 萬美元，同比上升 43.2%，環比下降 47.8%，主要由於本季度產生較大外幣匯兌損失。
- 母公司擁有人應佔溢利 8,390 萬美元，同比上升 90.4%，環比下降 18.5%。
- 基本每股盈利 0.064 美元，同比上升 88.2%，環比下降 19.0%。
- 淨資產收益率（年化）11.5%，同比上升 4.7 個百分點，環比下降 2.6 個百分點。

¹產能利用率按平均月約當產量除以總估計月產能計算。

²母公司擁有人應佔利潤 / 加權平均母公司擁有人應佔淨資產。

分部經營業績³
(以千美元計，營運數據除外)

	二零二二年 第二季度 (未經審核)	二零二一年 第二季度 (未經審核)	二零二二年 第一季度 (未經審核)	同比	環比
華虹 8 吋					
銷售收入	353,990	261,975	332,603	35.1 %	6.4 %
毛利	156,617	82,862	128,451	89.0 %	21.9 %
毛利率	44.2 %	31.6 %	38.6 %	12.6	5.6
經營開支	(35,157)	(20,835)	(40,587)	68.7 %	(13.4)%
稅前溢利	141,908	65,751	94,629	115.8 %	50.0 %
息稅折舊及攤銷前利潤	176,457	103,994	130,824	69.7 %	34.9 %
息稅折舊及攤銷前利潤率	49.8 %	39.7 %	39.3 %	10.1	10.5
付運晶圓(8 吋仔片)	567	546	571	3.8 %	(0.7)%
華虹無錫					
銷售收入	266,833	84,135	262,045	217.1 %	1.8 %
毛利	52,253	2,808	31,572	1,760.9 %	65.5 %
毛利率	19.6 %	3.3 %	12.0 %	16.3	7.6
經營開支	(35,519)	(25,070)	(34,677)	41.7 %	2.4 %
稅前溢利	(60,389)	(14,090)	609	328.6 %	(10,016.1)%
息稅折舊及攤銷前利潤	28,614	29,864	88,427	(4.2)%	(67.6)%
息稅折舊及攤銷前利潤率	10.7 %	35.5 %	33.7 %	(24.8)	(23.0)
付運晶圓(折合 8 吋仔片)	469	184	486	154.9 %	(3.5)%

華虹 8 吋

- 銷售收入 3.540 億美元，同比上升 35.1%，環比上升 6.4%。
- 毛利率 44.2%，同比上升 12.6 個百分點，環比上升 5.6 個百分點，主要得益於平均價格上漲。
- 經營開支 3,520 萬美元，同比上升 68.7%，主要由於人員開支上升，環比下降 13.4%，主要由於獎金減少。
- 稅前溢利 1.419 億美元，同比上升 115.8%，環比上升 50.0%。

華虹無錫

- 銷售收入 2.668 億美元，同比上升 217.1%，環比上升 1.8%。
- 毛利率 19.6%，同比上升 16.3 個百分點，環比上升 7.6 個百分點，主要得益於平均價格上漲。
- 經營開支 3,550 萬美元，同比上升 41.7%，主要由於研發活動的政府補助減少以及人員開支上升，環比上升 2.4%，主要由於研發活動的政府補助減少，部分被獎金減少所抵消。
- 息稅折舊及攤銷前利潤 2,860 萬美元，同比下降 4.2%，環比下降 67.6%，主要由於本季度產生較大外幣匯兌損失。

³以上各分部的經營業績均為抵消分部間銷售后的數據。

銷售收入分析

按類別劃分的 銷售收入	二零二二年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二二年 第二季度 % (未經審核)	二零二一年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二一年 第二季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
晶圓	600,865	96.8 %	331,384	95.7 %	269,481	81.3 %
其他	19,958	3.2 %	14,726	4.3 %	5,232	35.5 %
銷售收入總額	620,823	100.0 %	346,110	100.0 %	274,713	79.4 %

- 本季度 96.8%的銷售收入來源於半導體晶圓的直接銷售。

銷售收入分析

按晶圓尺寸劃分的 銷售收入	二零二二年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二二年 第二季度 % (未經審核)	二零二一年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二一年 第二季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
8 吋晶圓	353,990	57.0 %	261,975	75.7 %	92,015	35.1 %
12 吋晶圓	266,833	43.0 %	84,135	24.3 %	182,698	217.1 %
銷售收入總額	620,823	100.0 %	346,110	100.0 %	274,713	79.4 %

- 本季度來自於 8 吋晶圓和 12 吋晶圓的銷售收入分別為 3.540 億美元及 2.668 億美元。

銷售收入分析

按地域劃分的 銷售收入	二零二二年	二零二二年	二零二一年	二零二一年	同比	同比
	第二季度 仟美元 (未經審核)	第二季度 % (未經審核)	第二季度 仟美元 (未經審核)	第二季度 % (未經審核)	仟美元	%
中國 ⁴	450,449	72.6 %	255,218	73.8 %	195,231	76.5 %
美國 ⁵	73,213	11.8 %	29,528	8.5 %	43,685	147.9 %
亞洲 ⁶	57,937	9.3 %	38,515	11.1 %	19,422	50.4 %
歐洲	28,617	4.6 %	16,317	4.7 %	12,300	75.4 %
日本 ⁷	10,607	1.7 %	6,532	1.9 %	4,075	62.4 %
銷售收入總額	620,823	100.0 %	346,110	100.0 %	274,713	79.4 %

- 本季度來自於中國的銷售收入 4.504 億美元，占銷售收入總額的 72.6%，同比增長 76.5%，主要得益於各個技術平台產品的需求增加。
- 本季度來自於美國的銷售收入 7,320 萬美元，同比增長 147.9%，主要得益於其他電源管理及 MCU 產品的需求增加。
- 本季度來自於亞洲的銷售收入 5,790 萬美元，同比增長 50.4%，主要得益於邏輯、通用 MOSFET 及 MCU 產品的需求增加。
- 本季度來自於歐洲的銷售收入 2,860 萬美元，同比增長 75.4%，主要得益於通用 MOSFET、智能卡芯片及 IGBT 產品的需求增加。
- 本季度來自於日本的銷售收入 1,060 萬美元，同比增長 62.4%，主要得益於 MCU 及超級結產品的需求增加。

⁴包括香港。

⁵包括於 2020 年由一家總部位於歐洲的公司所收購的一家主要美國客戶。

⁶不包括中國及日本。

⁷包括於 2013 年由一家總部位於美國的公司所收購的一家主要日本客戶。

銷售收入分析

按技術平台劃分的 銷售收入	二零二二年	二零二二年	二零二一年	二零二一年	同比	同比
	第二季度	第二季度	第二季度	第二季度		
	仟美元	%	仟美元	%	仟美元	%
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)		
嵌入式非易失性存儲器	175,216	28.2 %	103,576	29.9 %	71,640	69.2 %
獨立式非易失性存儲器	69,595	11.2 %	18,325	5.3 %	51,270	279.8 %
分立器件	188,933	30.5 %	119,754	34.6 %	69,179	57.8 %
邏輯及射頻	77,046	12.4 %	57,016	16.5 %	20,030	35.1 %
模擬與電源管理	109,374	17.6 %	46,945	13.6 %	62,429	133.0 %
其他	659	0.1 %	494	0.1 %	165	33.4 %
銷售收入總額	620,823	100.0 %	346,110	100.0 %	274,713	79.4 %

- 本季度嵌入式非易失性存儲器銷售收入 1.752 億美元，同比增長 69.2%，主要得益於 MCU 及智能卡芯片的需求增加。
- 本季度獨立式非易失性存儲器銷售收入 6,960 萬美元，同比增長 279.8%，主要得益於 NOR flash 產品的需求增加。
- 本季度分立器件銷售收入 1.889 億美元，同比增長 57.8%，主要得益於 IGBT、通用 MOSFET 及超級結產品的需求增加。
- 本季度邏輯及射頻銷售收入 7,700 萬美元，同比增長 35.1%，主要得益於邏輯及 CIS 產品的需求增加。
- 本季度模擬與電源管理銷售收入 1.094 億美元，同比增長 133.0%，主要得益於其他電源管理產品的需求增加。

銷售收入分析

按工藝技術節點劃分的銷售收入	二零二二年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二二年 第二季度 % (未經審核)	二零二一年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二一年 第二季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
55nm 及 65nm	114,320	18.4 %	30,570	8.8 %	83,750	274.0 %
90nm 及 95nm	114,697	18.5 %	49,256	14.2 %	65,441	132.9 %
0.11 μ m 及 0.13 μ m	104,371	16.8 %	70,772	20.4 %	33,599	47.5 %
0.15 μ m 及 0.18 μ m	47,290	7.6 %	36,881	10.7 %	10,409	28.2 %
0.25 μ m	3,601	0.6 %	6,956	2.0 %	(3,355)	(48.2)%
0.35 μ m 及以上	236,544	38.1 %	151,675	43.9 %	84,869	56.0 %
銷售收入總額	620,823	100.0 %	346,110	100.0 %	274,713	79.4 %

- 本季度 55nm 及 65nm 工藝技術節點的銷售收入 1.143 億美元，同比增長 274.0%，主要得益於 NOR flash、CIS 及邏輯產品的需求增加。
- 本季度 90nm 及 95nm 工藝技術節點的銷售收入 1.147 億美元，同比增長 132.9%，主要得益於其他電源管理、智能卡芯片及 MCU 的需求增加。
- 本季度 0.11 μ m 及 0.13 μ m 工藝技術節點的銷售收入 1.044 億美元，同比增長 47.5%，主要得益於 MCU 產品的需求增加。
- 本季度 0.15 μ m 及 0.18 μ m 工藝技術節點的銷售收入 4,730 萬美元，同比增長 28.2%，主要得益於 MCU、邏輯及其他電源管理產品的需求增加。
- 本季度 0.25 μ m 工藝技術節點的銷售收入 360 萬美元，同比下降 48.2%，主要由於 RF 產品的需求減少。
- 本季度 0.35 μ m 及以上工藝技術節點的銷售收入 2.365 億美元，同比增長 56.0%，主要得益於 IGBT、通用 MOSFET、超級結及其他電源管理產品的需求增加。

銷售收入分析

按終端市場分佈劃分的銷售收入	二零二二年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二二年 第二季度 % (未經審核)	二零二一年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二一年 第二季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
電子消費品	404,719	65.2 %	220,519	63.7 %	184,200	83.5 %
工業及汽車	125,728	20.3 %	66,107	19.1 %	59,621	90.2 %
通訊	70,416	11.3 %	48,034	13.9 %	22,382	46.6 %
計算機	19,960	3.2 %	11,450	3.3 %	8,510	74.3 %
銷售收入總額	620,823	100.0 %	346,110	100.0 %	274,713	79.4 %

- 本季度電子消費品作為我們的第一大終端市場，貢獻銷售收入 4.047 億美元，占銷售收入總額的 65.2%，同比增長 83.5%，主要得益於各個技術平台產品的需求增加。
- 本季度工業及汽車產品銷售收入 1.257 億美元，同比增長 90.2%，主要得益於 MCU、IGBT 及智能卡芯片的需求增加。
- 本季度通訊產品銷售收入 7,040 萬美元，同比增長 46.6%，主要得益於邏輯、智能卡芯片及其他電源管理的需求增加。
- 本季度計算機產品銷售收入 2,000 萬美元，同比增長 74.3%，主要得益於通用 MOSFET 及 MCU 產品的需求增加。

產能⁸及產能利用率

晶圓廠(仟片晶圓每月)	二零二二年 第二季度 (未經審核)	二零二一年 第二季度 (未經審核)	二零二二年 第一季度 (未經審核)
1 號晶圓廠 (200mm)	65	65	65
2 號晶圓廠 (200mm)	60	60	60
3 號晶圓廠 (200mm)	53	53	53
7 號晶圓廠 (300mm)	65	40	65
合計折合 8 吋產能	324	268	324
產能利用率 (200mm)	110.0%	112.1%	107.7%
產能利用率 (300mm)	109.3%	104.1%	103.9%
總體產能利用率	109.7%	109.5%	106.0%

- 本季度末月產能達 324,000 片 8 吋等值晶圓。總體產能利用率為 109.7%，環比上升 3.7 個百分點。

⁸ 期末月產能，且為比較目的，以 30 天作為計算基礎。

付運晶圓

折合 8 吋矽片晶圓	二零二二年 第二季度 (未經審核)	二零二一年 第二季度 (未經審核)	二零二二年 第一季度 (未經審核)	同比	環比
付運晶圓	1,036	730	1,057	41.9 %	(2.0)%

- 本季度付運晶圓 1,036,000 片，同比增加 41.9%，環比減少 2.0%。

經營開支分析

以千美元計	二零二二年 第二季度 (未經審核)	二零二一年 第二季度 (未經審核)	二零二二年 第一季度 (未經審核)	同比	環比
銷售及分銷費用	2,530	1,988	4,496	27.3 %	(43.7)%
管理費用 ⁹	68,146	43,917	70,768	55.2 %	(3.7)%
經營開支	70,676	45,905	75,264	54.0 %	(6.1)%

- 經營開支 7,070 萬美元，同比上升 54.0%，主要由於人工開支上升及研發活動的政府補助減少，環比下降 6.1%，主要由於獎金減少。

其他(損失)/收入淨額

以千美元計	二零二二年 第二季度 (未經審核)	二零二一年 第二季度 (未經審核)	二零二二年 第一季度 (未經審核)	同比	環比
租金收入	3,852	3,544	3,781	8.7 %	1.9 %
利息收入	4,793	3,547	4,322	35.1 %	10.9 %
匯兌(損失)/ 收益	(56,555)	6,050	7,140	(1,034.8)%	(892.1)%
分佔聯營公司溢利	444	1,424	1,855	(68.8)%	(76.1)%
財務費用	(8,194)	(3,418)	(6,786)	139.7 %	20.7 %
政府補貼	496	376	1,842	31.9 %	(73.1)%
其他	(1,511)	373	(1,675)	(505.1)%	(9.8)%
其他(損失)/收入淨額	(56,675)	11,896	10,479	(576.4)%	(640.8)%

- 其他損失淨額 5,670 萬美元，主要由於本季度外幣匯兌損失較大，而上年同期及上季度均為外幣匯兌收益。

⁹管理費用包括確認為研發開支抵減項目的政府補助。

現金流量分析

以千美元計	二零二二年 第二季度 (未經審核)	二零二一年 第二季度 (未經審核)	二零二二年 第一季度 (未經審核)	同比	環比
經營活動所得現金流量淨額	212,259	99,127	195,589	114.1 %	8.5 %
投資活動所用現金流量淨額	(110,073)	(134,719)	(116,986)	(18.3)%	(5.9)%
融資活動(用)/所得現金流量淨額	(30,087)	40,584	2,439	(174.1)%	(1,333.6)%
外匯匯率變動影響淨額	(59,383)	8,024	3,752	(840.1)%	(1,682.7)%
現金及現金等價物變動影響淨額	12,716	13,016	84,794	(2.3)%	(85.0)%

- 本季度經營活動所得現金流量淨額 2.123 億美元，同比上升 114.1%，主要得益於銷售收入增長，部分被人工費用和材料的支出增加所抵消。
- 投資活動所用現金流量淨額 1.101 億美元，其中固定資產及無形資產投資支出 1.124 億美元，部分被收到利息收入 180 萬美元及政府對設備的補助 50 萬美元所抵消。
- 融資活動所用現金流量淨額 3,010 萬美元，其中償還銀行貸款本金 5,450 萬美元，支付銀行借款利息 1,250 萬美元及租賃負債支出 50 萬美元，部分被提取銀行借款 3,700 萬美元和發行股份收到 40 萬美元所抵消。

資本結構

以千美元計	於六月三十日 二零二二年 (未經審核)	於三月三十一日 二零二二年 (未經審核)
資產總額	6,240,744	6,316,078
負債總額	2,608,878	2,531,648
所有者權益總額	3,631,866	3,784,430
資產負債率 ¹⁰	41.8%	40.1%

資本開支

以千美元計	二零二二年 第二季度 (未經審核)	二零二二年 第一季度 (未經審核)
華虹 8 吋	17,179	16,553
華虹無錫	95,174	107,527
合計	112,353	124,080

- 本季度資本開支 1.124 億美元，其中 9,520 萬美元用於華虹無錫。

¹⁰資產負債率=負債總額/資產總額。

流動性分析

以千美元計	於六月三十日 二零二二年 (未經審核)	於三月三十一日 二零二二年 (未經審核)
發展中物業	121,026	125,110
存貨	473,935	451,671
貿易應收款項及應收票據	241,967	243,443
預付款項、其他應收款項及其他資產	63,186	50,060
應收關聯方款項	14,212	7,074
已凍結存款及定期存款	349	2,258
現金及現金等價物	1,707,650	1,694,934
流動資產總額	2,622,325	2,574,550
貿易應付款項	303,263	243,211
其他應付款項及暫估費用	575,171	513,204
計息銀行借款	231,334	194,304
租賃負債	3,309	2,524
政府補助	66,876	67,127
應付關聯方款項	15,630	19,949
應付所得稅	35,532	67,538
流動負債總額	1,231,115	1,107,857
淨營運資金	1,391,210	1,466,693
速動比率	1.7x	1.9x
流動比率	2.1x	2.3x
貿易應收款項及應收票據周轉天數	35	32
存貨周轉天數	101	92

- 預付款項、其他應收款項及其他資產 由上季度末的 5,010 萬美元上升至本季度末的 6,320 萬美元，主要由於待抵扣進項稅增加。
- 貿易應付款項 由上季度末的 2.432 億美元上升至本季度末的 3.033 億美元，主要由於供應商應付款增加。
- 其他應付款項及暫估費用 由上季度末的 5.132 億美元上升至本季度末的 5.752 億美元，主要由於應付資本性開支增加。
- 計息銀行借款由上季度末的 1.943 億美元上升至本季度末的 2.313 億美元，主要由於一年內到期的長期借款增加。
- 應付所得稅由上季度末的 6,750 萬美元下降至本季度末的 3,550 萬美元，主要由於本季度支付 2021 年度所得稅，部分被本季度計提所得稅開支所抵消。
- 淨營運資金 本季度末 13.912 億美元，流動比率 2.1。
- 貿易應收款項及應收票據周轉天數 35 天。
- 存貨周轉天數 101 天。

上述公佈詳情請參閱華虹半導體網站 www.huahonggrace.com。

華虹半導體有限公司
簡明損益表(以千美元計,每股盈利和股數除外)

	截至以下日期止三個月		
	於六月三十日 二零二二年 (未經審核)	於六月三十日 二零二一年 (未經審核)	於三月三十一日 二零二二年 (未經審核)
銷售收入	620,823	346,110	594,648
銷售成本	(411,953)	(260,440)	(434,625)
毛利	208,870	85,670	160,023
其他收入及收益	9,441	13,898	17,721
投資物業的公平值收益	-	-	(316)
銷售及分銷費用	(2,530)	(1,988)	(4,496)
管理費用	(68,146)	(43,917)	(70,768)
其他費用	(58,366)	(8)	(1,995)
財務費用	(8,194)	(3,418)	(6,786)
分佔聯營公司溢利	444	1,424	1,855
稅前溢利	81,519	51,661	95,238
所得稅(開支)/ 抵免	(28,272)	(14,483)	6,865
期內溢利	53,247	37,178	102,103
以下各方應佔利潤			
母公司擁有人	83,933	44,082	102,944
非控股權益	(30,686)	(6,904)	(841)
持有人應佔每股盈利			
基本	0.064	0.034	0.079
攤薄	0.064	0.033	0.078
用於計算持有人應佔每股基本盈利的 期內已發行普通股加權平均數	1,301,760,320	1,300,192,217	1,301,453,841
用於計算持有人應佔每股攤薄盈利的 期內已發行普通股加權平均數	1,316,099,219	1,325,014,217	1,319,204,155

華虹半導體有限公司
簡明綜合財務狀況表(以千美元計)

	截至		
	於六月三十日 二零二二年 (未經審核)	於三月三十一日 二零二二年 (未經審核)	於六月三十日 二零二一年 (未經審核)
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備	2,955,516	3,053,141	2,710,002
投資物業	175,337	185,369	182,287
使用權資產	81,994	76,681	76,997
無形資產	31,516	33,487	35,784
於聯營公司的投資	118,129	124,420	110,699
以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的權益工具	221,072	236,005	232,575
長期預付款項	24,890	23,710	17,407
應收關聯方款項	-	-	40
遞延稅項資產	9,965	8,715	10,501
非流動資產總額	3,618,419	3,741,528	3,376,292
流動資產			
發展中物業	121,026	125,110	107,865
存貨	473,935	451,671	355,881
貿易應收款項及應收票據	241,967	243,443	108,358
預付款項、其他應收款項及其他資產	63,186	50,060	61,448
應收關聯方款項	14,212	7,074	6,253
已凍結存款及定期存款	349	2,258	362
現金及現金等價物	1,707,650	1,694,934	974,522
流動資產總額	2,622,325	2,574,550	1,614,689
流動負債			
貿易應付款項	303,263	243,211	147,074
其他應付款項及暫估費用	575,171	513,204	491,089
計息銀行借款	231,334	194,304	138,627
租賃負債	3,309	2,524	2,010
政府補助	66,876	67,127	76,611
應付關聯方款項	15,630	19,949	18,723
應付所得稅	35,532	67,538	22,165
流動負債總額	1,231,115	1,107,857	896,299
流動資產淨額	1,391,210	1,466,693	718,390
總資產減流動負債	5,009,629	5,208,221	4,094,682
非流動負債			
計息銀行借款	1,346,974	1,400,496	616,254
租賃負債	15,687	15,429	16,463
遞延稅項負債	15,102	7,866	10,391
非流動負債總額	1,377,763	1,423,791	643,108
淨資產	3,631,866	3,784,430	3,451,574
權益和負債權益			
股本	1,987,494	1,987,216	1,984,207
儲備	901,446	980,308	652,280
本公司擁有人應佔權益	2,888,940	2,967,524	2,636,487
非控股權益	742,926	816,906	815,087
權益總額	3,631,866	3,784,430	3,451,574

華虹半導體有限公司
簡明綜合現金流量表(以千美元計)

	截至以下日期止三個月		
	於六月三十日 二零二二年 (未經審核)	於六月三十日 二零二一年 (未經審核)	於三月三十一日 二零二二年 (未經審核)
經營活動所得現金流量：			
稅前溢利	81,519	51,661	95,238
折舊及攤銷	115,358	78,786	117,227
應佔聯營公司溢利	(444)	(1,424)	(1,855)
營運資金的變動及其它	15,826	(29,896)	(15,021)
經營活動所得現金流量淨額	212,259	99,127	195,589
投資活動所用現金流量：			
購買物業、廠房、設備及無形資產項目	(112,353)	(136,535)	(124,080)
收到政府對物業、廠房及設備的補助	449	-	4,356
其他投資活動所得現金流量	1,831	1,816	2,738
投資活動所用現金流量淨額	(110,073)	(134,719)	(116,986)
融資活動所(用)/得現金流量：			
提取銀行貸款	36,971	47,590	47,413
發行股份所得收益	393	151	1,252
償還銀行貸款	(54,465)	(2,322)	(43,208)
償還租賃負債	(545)	(827)	(2,484)
已付利息	(12,441)	(4,008)	(534)
融資活動所(用)/得現金流量淨額	(30,087)	40,584	2,439
現金及現金等價物增加淨額	72,099	4,992	81,042
外匯匯率變動影響淨額	(59,383)	8,024	3,752
期初現金及現金等價物	1,694,934	961,506	1,610,140
期末現金及現金等價物	1,707,650	974,522	1,694,934

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

張素心(董事長)

唐均君(總裁)

非執行董事

孫國棟

王靖

葉峻

獨立非執行董事

張祖同

王桂壩太平紳士

葉龍蜚

承董事會命

華虹半導體有限公司

張素心

董事長兼執行董事

中國 香港

二零二二年八月十一日